

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年11月16日
【会社名】	株式会社メガチップス
【英訳名】	MegaChips Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 明
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
【電話番号】	06(6399)2884(代表)
【事務連絡者氏名】	管理統括部経営企画課広報グループリーダー 三宅 正久
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
【電話番号】	06(6399)2884(代表)
【事務連絡者氏名】	管理統括部経営企画課広報グループリーダー 三宅 正久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成24年11月16日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の連結子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

当該吸収合併の相手会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	川崎マイクロエレクトロニクス株式会社
本店の所在地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
代表者の氏名	代表取締役社長 山内 由紀夫
資本金の額	5,046百万円（平成24年3月期）
純資産の額	(連結) 9,632百万円（平成24年3月期） (単体) 8,816百万円（平成24年3月期）
総資産の額	(連結) 15,179百万円（平成24年3月期） (単体) 14,762百万円（平成24年3月期）
事業の内容	半導体集積回路の設計、製造及び販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(連結)

決算期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	24,692百万円	24,176百万円	21,413百万円
営業利益又は営業損失()	317百万円	1,857百万円	1,714百万円
経常利益又は経常損失()	911百万円	1,694百万円	1,535百万円
当期純利益又は当期純損失()	1,423百万円	1,389百万円	23百万円

(単体)

決算期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	24,044百万円	23,868百万円	20,915百万円
営業利益又は営業損失()	431百万円	1,829百万円	1,719百万円
経常利益又は経常損失()	1,031百万円	1,667百万円	1,534百万円
当期純利益又は当期純損失()	1,504百万円	1,378百万円	20百万円

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（平成24年7月1日現在）

大株主の名称 株式会社メガチップス

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100%

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社は川崎マイクロエレクトロニクス株式会社の発行済株式の全部を所有しております。

人的関係 当社の役員7名が、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社の役員を兼任しております。

取引関係 当社は川崎マイクロエレクトロニクス株式会社に事業資金を融資しております。

(2) 当該吸収合併の目的

エレクトロニクス・半導体分野においては、技術革新が急速に進展し、従来のビジネスモデルが陳腐化するなど、業界は世界的な転換期を迎えており、当社を取り巻く環境は大きく変化しております。このような環境の中で、顧客と共存共栄し、これまで以上に社会に貢献しつつ、変化に適応しながら継続的な発展を図るため、当社と川崎マイクロエレクトロニクス株式会社は経営資源を結集いたします。

これにより、環境の変化にも耐えうる、継続して安定的な収益を獲得する事業ポートフォリオを構築し、アプリケーションやシステム企画、ソリューション提供を主軸として、グローバルな展開を図る準備を進めてまいります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容及びその他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とし、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

吸収合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

その他の吸収合併契約の内容

合併契約書の内容は、「(6) 合併契約書（写し）」のとおりであります。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社メガチップス
本店の所在地	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 高田 明
資本金の額	4,840百万円
純資産の額	24,393百万円（注）
総資産の額	45,910百万円（注）
事業の内容	システムLSI、自社システムLSIを使った電子部品及びシステム機器の設計、開発、製造（外部委託）及び販売

（注）平成24年9月30日現在の数値を基に算定した概算値であります。

(6) 合併契約書（写し）

合 併 契 約 書

株式会社メガチップス（以下「甲」という）と川崎マイクロエレクトロニクス株式会社（以下「乙」という）は、次のとおり合併契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（合併の方法）

甲および乙は、甲が乙を吸収合併して存続するものとし、乙は解散するものとする（以下「本合併」という）。

第2条（商号および住所）

吸収合併存続会社（甲）および吸収合併消滅会社（乙）の商号および住所は次のとおりとする。なお、本合併に伴う甲の商号および住所の変更はないものとする。

（吸収合併存続会社）

商号：株式会社メガチップス

住所：大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号

（吸収合併消滅会社）

商号：川崎マイクロエレクトロニクス株式会社

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

第3条（合併に際し交付する金銭等）

甲は、乙の発行済株式のすべてを保有しているため、本合併に際し、甲の株式その他の金銭等の割当交付を行わないものとする。

第4条（資本金および準備金の額）

本合併により、甲の資本金および準備金は増加しないものとする。

第5条（合併承認総会）

本合併については、甲は会社法第796条第3項の規定に基づき、また、乙は会社法第784条第1項の規定に基づき、それぞれ株主総会決議による承認を得ることなく合併するものとする。

第6条（効力発生日）

本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は2013年4月1日とする。ただし、本合併手続の進行に応じ、また、その他の事由により必要があるときは、甲乙協議のうえ変更することができるものとする。

第7条（承継する会社財産）

甲は、効力発生日において、2012年3月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎としこれに効力発生日前日までの増減を加除した乙の一切の資産、負債および権利義務を承継するものとする。

第8条（会社財産の管理）

乙は、効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって、その業務の執行および財産の管理・運営を行い、その財産および権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、予め甲との間で協議および合意したうえで行うものとする。

第9条（従業員の処遇）

甲は、効力発生日において、乙および乙の子会社の従業員を引継ぐものとし、かかる従業員の取扱については別途甲乙協議のうえ決定するものとする。

第10条（本契約の解除等）

効力発生日前日までに天変地異その他の事由により本合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、甲乙協議のうえで本合併もしくは本契約の条件・内容を変更し、または本契約を解除することができるものとする。

第11条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙誠実に協議して定めるものとする。

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、甲が原本を保有し乙はその写しを保有する。

2012年11月16日

甲：大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
株式会社メガチップス
代表取締役社長 高田 明

乙：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
川崎マイクロエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 山内 由紀夫